

底部填充胶芯片保护固化速度快

产品名称	底部填充胶芯片保护固化速度快
公司名称	深圳市聚芯源新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区A8栋101
联系电话	13537566612 18028708139

产品详情

一、底部填充胶的优势1. 高效保护：底部填充胶能紧密贴合芯片表面，提供全方位的保护，防止尘埃、水分和其他有害物质对芯片的侵害。2.

快速固化：我们的底部填充胶固化速度快，大大缩短了生产周期，提高了生产效率。3.

易于使用：操作简便，无需复杂的工艺，为您节省了宝贵的时间和资源。4.

环保安全：底部填充胶符合环保标准，无毒无害，使用起来更加安心。二、如何使用底部填充胶1.

清洁芯片表面：确保芯片表面干净、无尘，以利于底部填充胶的附着。2.

均匀涂覆：将底部填充胶均匀涂抹在芯片底部，确保覆盖全面。3.

自然固化：等待底部填充胶自然固化，无需额外加热。4. 检查效果：固化完成后，检查芯片是否得到充分保护，如有需要，可进行适当调整。三、我们的承诺我们承诺为您提供高质量的底部填充胶产品，确

保您获得优质的效果。如有任何问题，我们的专业团队将随时为您提供帮助。